Connect Tech

2025 PRODUCT GUIDE

製品ガイド

NVIDIA Elite Partner

WWW.CONNECTTECH.COM

QUALITY& STANDARDS

品質と規格

- ▶ ISO 9001:2015 認証
- ▶ カナダ管理製品
- ▶ ITAR 認証, 米国共同認定
- ▶ MIL-STD-810H, DO-160G；衝撃・振動試験
- ▶ 防塵防水 保護等級(IP)

TABLE OF CONTENTS / 目次

NVIDIA® SOLUTIONS

JETSON AGX ORIN 4
JETSON AGX ビジョンソリューション 6
JETSON ORIN NX & ORIN NANO 8
JETSON 製品ライフサイクル 11
JETSON モジュール比較 12
実証済みのエッジ AI パフォーマンス 14
Connect TechとNVIDIA ISAAC ROSによる リアルタイム・ロボティクス 15
JETSON XAVIER NX & NANO 16
JETSON サーマルソリューション&アクセサリ 18
COM EXPRESS + 組み込み GPU ソリューション 20

COMPUTER-ON-MODULE

VPX 製品 21
COM-HPC キャリアボード 22
COM EXPRESS キャリアボード 22

EMBEDDED ETHERNET DEVICES

10GbE ソリューション 24
1GbE ソリューション 25

NVIDIA Elite Partner

NVIDIA最大のグーロバル
Jetsonハードウェアパートナー

intel partner alliance

MADE IN NORTH AMERICA

※記載の仕様は、予告なく変更することがあります。

EMBEDDED SYSTEMS

NEW!

Sentry-X2

過酷な環境でのミッションクリティカルなアプリケーションのためにデザインされたSentry-X2は、タクティカルエッジでのコンピューティングのためのMIL-SPECのAI組み込みシステムです。

- NVIDIA® Jetson AGX Orin industrial
- IP67、MIL-STD 810Hテスト
- 8x GMSL2カメラ入力
- ATX 冗長電源ユニット
- 3xイーサネットポート:
  10GbE, 2.5GbE, 1GbE

ESG630

NEW!

Anvil-RX

Anvil-RXは、NVIDIA Jetson AGX Orinを搭載した堅牢なエッジデバイスです。IP67に準拠したAnvil-RXは、過酷な環境におけるミッションクリティカルなアプケーションに適しています。

- 8x GMSL2カメラ入力
- 堅牢なM12防水コネクター
- 最大 1x 4TB NVMe
- 2x 10G BASE-Tイーサネット
  2x 1G BASE-Tイーサネット
- - 動作温度: -40℃ ～ +65℃

ESG635

NEW!

AGX Orin™ Inference Server

AGX Orin Inference Serverψ " 12x NVIDIA Jetson AGX OrinЯ S в ． и б ﻡ ∏ ů θ ‰ Ч ﻫ AIм ． ρ I Г ． Є д р π β ‘ NVIDIA χ Ω F ё σ Д и ． Ф ж ． И р ЭЊ T E j Θ † б β Ω τ ◻ “ π Φ Q β ‘

- 12x Jetson AGX Orin
  (275 TOPS, 2048È † GPU, 64TensorÈ †)
- 4x 10G SFP+ † A Φ з р ρ Ò
- Я S в ． и K θ Ч ' Ω ﻫ 2TB χ NVMe I E й ． S
- 2U ATX ﻫ ﻣﻌﺖ Ḥ г И A E

UAGX2U

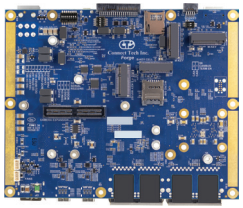
Anvil for AGX Orin™

ﻫ ˆ τ ﻫ " ﻫ σ IF б ﻫ П о Σ Ч " ů ■ χ ﻫ MAI † Φ з Є ． Є д р τ ﻫ æ ů Q β ‘ w Ω ﻫ χ ﻫ ﻫ Ж э " I Ы ． E Є Г и † Φ з Є ． Є д р " P S д р Њ з в ． Є д р б Є ． Э й I τ ﻫ ﻫ π Φ Q β ‘

- 2x 10G イーサネット
- 8x GMSL2/FPD-Link III/HD-SDI
  カメラ入力 (オプション)
- 2x NVMe M.2 M-Key,
  1x B-Key(LTE), 1x E-Key(WiFi/BT)
- USB 3.2, External PCIe
- 入力電源: +10V ~ +36V

ESG620/ESG621

CARRIER BOARDS



Forge

NVIDIA Jetson AGX Orinのためのフル機能キャリアボード。このキャリアボードは、商用展開可能なプラットフォーム向けに設計されています。

- 2x 10Gイーサネット
- 2x NVMe M.2 M-Key, 1x M.2 B-Key, 1x M.2 E-Key
- USB 3.2, PCIe x4 OCuLink
- 広い入力電力範囲: 10V - 36V DC

AGX201

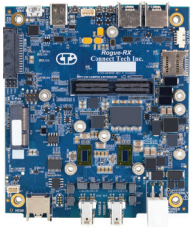
Rogue for AGX Orin™

NVIDIA Jetson AGX Orinのためのスモールフォームファクタキャリア。商用展開可能なプラットフォーム向けにデザインされており、92 x 107mmという非常に小さなフットプリントを実現しています。

- 2x 10Gイーサネット
- 超小型フォームファクタ（AGX Orinモジュールとほぼ同サイズ）
- 2x NVMe M.2 key
- 3x USB 3.2

AGX202

NEW!



Rogue-RX for AGX Orin™

Rogue-RXは、過酷な環境向けに設計された堅牢なフル機能のキャリアボードです。堅牢なポジティブロックハイスピードコネクタを提供します。

- 堅牢なポジティブロックコネクタ
- 2x 10Gイーサネット
- 超小型フォームファクタ（AGX Orinモジュールと同サイズ）
- 2x NVMe M.2 key
- 3x USB 3.2

AGX203

VPX

NEW!

Graphite VPX

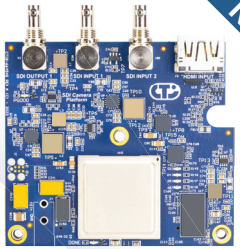
GraphiteVPX/AGX Orinは、NVIDIA Jetson AGX Orinを非常に堅牢な組み込みVPXマーケットにもたらします。3Uサイズのカードで、USB3.2, DisplayPort, NVMeを搭載しています。

- 3U VPX SOSAアライメント
- NVIDIA Jetson AGX Orin Industrial
- PCIe x8 Gen4
- 2x 10GBASE-KRイーサネット
- 完全なIPMIサポート
- 産業用NVMe 1TB/2TB

VPG004

CAMERA BOARDS

NEW!



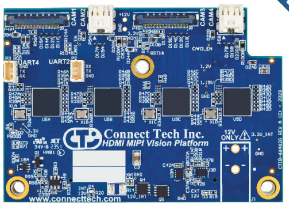
Jetson SDI Vision Platform

SDIカメラ拡張プラットフォームは、低ハードウェアレイテンシー, SDI-to-MIPI CSI-2変換を可能とし、追加ハードウェアなしでNVIDIA Jetsonプラットフォーム上のGPUに直接ISP取り込みパスを提供します。

- 2x 3G-SDI入力, 1x 3G-SDI出力(HD-BNC)
- 1x HDMI(Type-A)入力
- 1x 高密度コネクタ

JCB003

NEW!

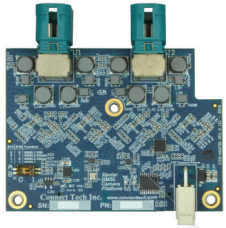


HDMI Vision Platform

HDMI Vision Platform は、NVIDIA Jetsonへの入力のためにMIPI CSI-2に変換し、直接HDMIビデオ入力を可能とします。

- 2x30ピン同軸(ソニーFCB対応), デュアルマイクロHDMI
- ビジョン処理のために HDMIからCSI-2へ変換
- ボード上の拡張ヘッダから直接給電
- 最大4x HDMI入力

JCB010

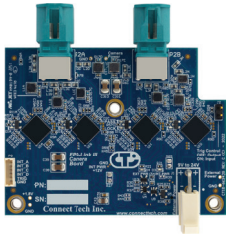


GMSL Camera Board

GMSL Camera Boardは、最大8台のGMSL1/GMSL2カメラをサポートし、Connect TechのすべてのAGX Orinキャリアボードに接続できます。

- GMSL1またはGMSL2プロトコル
- 内部(Jetson Module)または外部(ボード上の拡張ヘッダー)から給電
- Power over Coax; 4xミニ同軸コネクタ
- Jetson AGX ISPへの直接パスでより長いケーブリングが可能

JCB002

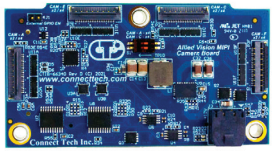


FPD-Link III Camera Board

FPD-Link III Camera Boardは、最大8台のFPD-Link III カメラをAGX Orinキャリアボードに接続できます。

- 8x FPD-Link IIIカメラ入力 (4x デシリアライザ)
- 16-lane MIPI出力; デシリアライザ当たり4-laneMIPI CSI-2
- 内部(Jetson Module)または外部(ボード上の拡張ヘッダー)から給電
- Power over Coax

JCB006



Allied Vision MIPI Camera Board

Allied Vision MIPI Camera Board は、ハードウェアを追加することなく、最大6台のAllied Vision社のMIPIセンサーをJetsonへ直接接続できます。

- Jetson AGX Orin への Allied VIsion社 MIPI CSI-2センサーの容易な統合
- 最大6台の2-laneまたは 4台の4-lane MIPIカメラを接続可能
- Jetson AGX Orinキャリアボードへの シームレスな統合

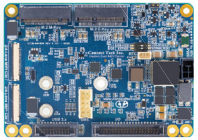
JCB005

CAMERA BOARD COMPARISON CHART

	HDMI Vision Camera Platform	Allied Vision MIPI Camera Board	GMSL Camera Board	FPD-Link III Camera Board	Jetson SDI Vision Platform
Part Number	JCB010	JCB005	JCB002	JCB006	JCB003
Size	75mm x 52mm (2.95" x 2.05")	75mm x 40.2mm (2.95" x 1.58")	75mm x 57mm (2.95" x 2.24")	75mm x 57mm (2.95" x 2.24")	75mm x 57mm (2.95" x 2.24")
Weight	23g	19g	50g	37g	53g
Connector	1x High Density Connector Camera Board will mate to the Camera Expansion Header on the Rogue, Rogue-X, Forge and Rogue for Orin, and Rogue-RX Carrier Boards				
Camera Inputs	4x HDMI Inputs	Up to 6x MIPI CSI-2 (4x 4-lane or 6x 2-lane)	8x Total (GMSL2/GMSL1)	8x Total	2x 3G-SDI Inputs (HD-BNC)
Deserializer	N/A		Maxim MAX9296A	Texas Instruments DS90UB954	N/A
MIPI Output	A single 4-lane MIPI CSI-2 output from each Bridge (16-lanes total)	4x 4-lane, or 6X 2-lane MIPI CSI-2	A single 4-lane MIPI CSI-2 v1.3 output from each Deserializer (16-lanes total)	A single 4-lane MIPI CSI-2 v1.3 output from each Deserializer (16-lanes total)	4-lane MIPI CSI-2 v1.3 output per SDI Input (8-lanes total)
Camera Input Connectors	2x KEL USL00-30L 2x HDMI Type D (Micro HDMI)	6x MIPI CSI-2 connectors to interface to Allied Vision Alvium cameras	2x MATE-AX Quad Coax Connectors Breakout cables to FAKRA available	2x MATE-AX Quad Coax Connectors Breakout cables to FAKRA available	2x Right Angle HD-BNC Connectors
Power	Directly powered from Camera Expansion Header		All 8 cameras will be sourced Power-Over-COAX from JCB002	All 8 cameras will be sourced Power-Over-COAX from JCB006	+12V is available from Camera Expansion Header as external connector if more power is required
Operating Temperature	-30°C to +70°C (-22°F to +158°F)	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)			

HADRON CARRIER BOARDS

NEW!



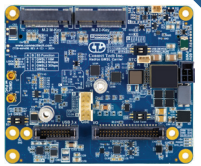
Hadron Dual MIPI

Hadron Dual MIPI は、ビジョンアプリケーションや無人ペイロードのためのコンパクトなキャリアです。堅牢なラッチングコネクターにより、過酷な環境でも確実な接続が可能です。

- 2x USB 3.1, 1x GbE, 1x 2242/2230 NVMe, 1x M.2 E-key(WiFi/BT)
- GPIO, PWM, I2C, RS-232, 3.3V UART, SPI
- 電源入力: +9V ～ +60V

NGX024

NEW!

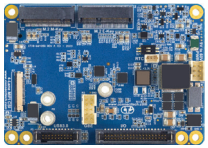


Hadron GMSL

Hadron GMSLは、デュアルGMSL2カメラ入力が可能です。自律アプリケーションに不可欠な高速で信頼性の高いデータ通信を保証します。

- 2x USB3.1, 1x GbE, 2x GMSL同軸ポート
- 1x NVMe M-key, 1x M.2 E-key
- 堅牢なポジティブロック・ピンヘッダ付きイーサネットコネクタ

NGX018



Hadron

Hadronは、エッジでのAIコンピューティングのための超小型で堅牢かつ豊富なIFを備えたキャリアボードです。 そのサイズはJetson SODIMMモジュールとほぼ同じです。

- 小さなフットプリント: 82.6mm x 58.8mm
- 2x USB 3.1, 1x GbE, 1x 4-lane MIPI CSI-2, 1x USB OTG
- 電源入力: +9V ～ +60V

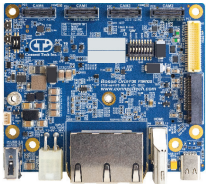
NGX012

	Hadron	Hadron GMSL	Hadron Dual MIPI
Part Number	NGX012	NGX018	NGX024
Size	82.6mm x 58.8mm (3.25" x 2.31")	82.7mm x 68.8mm (3.25" x 2.71")	82.6mm x 58.8 mm (3.25" x 2.22")
Ethernet	1x 1000BASE-T with Rugged Positive Locking Pin Headers		
USB	2 x USB 3.1 (Gen 1) 1x USB 2.0 Programming Port	2x USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps) with Rugged Positive Locking Pin Header	2x USB 3.1 Gen 1x1
Camera Inputs	1x 4-lane MIPI CSI-2	2x GMSL2 Camera inputs w/ PoC	2x 4-lane MIPI CSI-2 (22-pin connector)
Storage	1x 2242/2230 NVMe (M-Key)	1x 2242 NVMe (M-Key)	1x 2242/2230 NVMe (M-Key)
Misc Interfaces	1x 3.3VTTL UART (CONSOLE) 2x RS-232 Serial Ports 4x PWM capable GPIO 1x 3.3V I2C, 1x 3.3V SPI	1x CAN 2.0b 1x 3.3VTTL UART (CONSOLE) 2x RS-232 Serial Ports 4x PWM capable GPIO 1x 3.3V I2C	1x 3.3VTTL UART (CONSOLE) 2x RS-232 Serial Ports 4x PWM capable GPIO 1x 3.3V I2C, 1x 3.3V SPI
Power	+9V to +60V DC (+12V to +48V DC Nom.)		
Weight	49g	58g	49g
Temperature	-25°C to +85°C (-13°F to 185°F)		

BOSON CARRIER BOARDS

	Boson for Orin	Boson-22
Part Number	NGX020	NGX021
Display	1x HDMI 2.0	
Storage	1x M.2 M-Key (2280) NVMe PCIe x4 (Gen 3)	
Expansion	1x 2230 E-Key Expansion for WiFi/Bluetooth 1x PCIe x1 + USB 2.0	
Vision	MIPI CSI x4 Connectors	22 Pin MIPI CSI x4 Connectors
USB	1x USB 3.1 Gen 2 w/ OTG capability (Type C) 1x USB 2.0 (Type A)	
Power	+9V to +36V Input Voltage Range	
Misc. Interfaces	3x 3.3V TTL UARTs (1x CONSOLE) 8 GPIOs 3.3V TTL (2x PWM Capable) 2x I2C 3.3V, 1x CAN 2.0b, 2x SPI, 2x 3.3V, 2x 5V, 8x GND	
Operating Temperature	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)	
Weight	80g (2.82oz)	
Dimensions	90mm x 75mm (3.54" x 2.95")	

NEW!



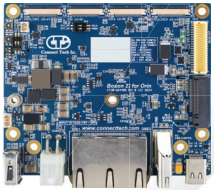
Boson For Orin

Bosonは非常に小さなフットプリントで最大4台のFRAMOS社MIPIカメラを統合します。Bosonは、ハイエンドのビジョンアプリケーション向けに、センサー入力とストレージソリューションを最大化します。

- NVIDIA Jetson Orin NX および Orin Nanoに対応
- 最大4x 2-laneまたは2x 4-lane MIPI FRAMOSセンサモジュールを統合
- デュアルギガビットイーサネットおよびデュアルUSB
- 追加ストレージ用NVMe

NGX020

NEW!



Boson-22

Boson-22 は、小型でパワフルなビジョン向けキャリアです。4x22ピンMIPIカメラ入力, 2x GbE, USB Type-Cを搭載し、堅牢でコンパクトなパッケージに収められています。

- 2x 4-lane, 2x 4-lane+2x 2-lane, または4x 2-lane MIPI モジュール接続
- デュアルGbE, USB Type-C, USB3.0
- 追加ストレージ用NVMe, WiFiおよびBluetooth拡張オプション
- 入力電源: +9V ~ +36V

NGX021

EMBEDDED SYSTEMS

NEW!

Orin™ NX Inference Server

Jetson Orin NX Inference Server は、NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載した、低消費電力で高性能なディープラーニング推論サーバーです。

- 最大 24x Jetson Orin NX (100TOPS, 1024 GPU CUDAコア)
- 4x 10G SFP+ アップリンク機能
- 動作温度範囲: 0°C ~ +50°C

UNGX2U

Polaris

Polarisは、Jetson Orin NXを搭載し、ロボット工学、スマートシティ、自律型マシン向けに設計されています。IP67規格の堅牢なパッケージで豊富なI/Oを提供します。

- IP67規格, アクティブ/パッシブクーリング
- 堅牢なM12コネクタ: 2x GbE, 2x CAN, GPIO, 2x USB3.1, 広範な入力の絶縁電源(+18V ~ +48V)
- シールされたFAKRA 4x GMSL2 入力, M.2 2280 NVME M-Key, GNSS 拡張

ESG604/ESG608

Rudi-NX for Orin

Rudi-NX for Orin は、Jetson Orin NX を搭載し、最先端のエッジAIコンピューティングデバイスです。最大4台のGMSLカメラ入力が可能です。

- 極めて小さなフットプリント: 135mm x 50mm x 109mm
- 4x GMSL, USB 3.0, USB 2.0, CAN 2.0b, USB OTG, RS-485, I2C, GPIO, SPI, PWM
- 1x NVMe (PCIe x4, 2280)
- 動作温度範囲: -20°C ~ +80°C

ESG605

Rudi-NX FPD-Link III

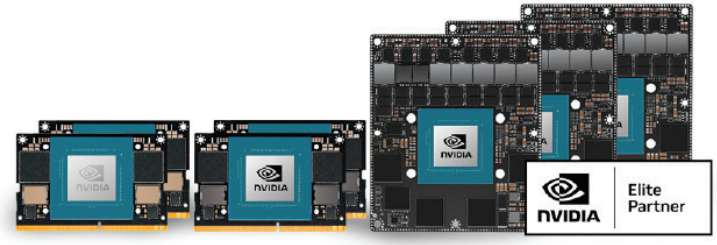
Rudi-NX FPD-Link IIIは、Jetson Orin NXを搭載した最先端かつ計算負荷の高いアプリケーションのためのコンピューティングソリューションです。最大4台のFPD-Link IIIカメラ入力が可能です。

- 極めて小さなフットプリント: 135mm x 50mm x 109mm
- 4x FPD-Link III, USB3.0, USB 2.0, CAN 2.0b, USB OTG, RS-485, I2C, GPIO, SPI, PWM
- 1x NVMe (PCIe x4, 2280)
- 動作温度範囲: -20°C ~ +80°C

ESG606

NVIDIA® JETSON™ PRODUCT LIFECYCLE

製品ライフサイクル



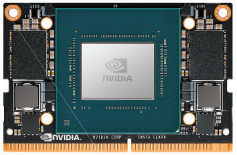
Jetson Module	提供期間	Jetson Module	提供期間
Jetson AGX Orin 64GB	~2030年1月	Jetson AGX Xavier (32GB)	~2028年1月
Jetson AGX Orin 32GB	~2030年1月	Jetson AGX Xavier Industrial	~2031年7月
Jetson AGX Orin Industrial	~2033年7月	Jetson Xavier NX 16GB	~2026年1月
Jetson Orin NX 16GB	~2030年1月	Jetson Xavier NX (8GB)	~2028年1月
Jetson Orin NX 8GB	~2030年1月	Jetson TX2 NX	~2028年2月
Jetson Orin Nano 8GB	~2030年1月	Jetson TX2	~2025年1月
Jetson Orin Nano 4GB	~2030年1月	Jetson TX2i	~2028年4月
Jetson AGX Xavier 64GB	~2025年1月	Jetson Nano	~2027年1月

Product Change Notifications / 製品変更通知(PCN)

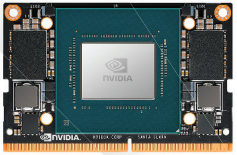
製品のライフサイクル中に、ハードウェアコンポーネントの変更とそれに伴うソフトウェアの変更が発生する可能性があります(メモリコンポーネントの更新など)。以下のQRコードをスキャンして、Connect Techの製品変更に関する最新情報をご確認ください。

End of Life Notifications / 製品終息通知(EOL)

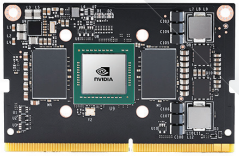
正式な製品終息通知は、最終出荷の最低8ヶ月前に送信されます。
以下のQRコードをスキャンして、EOL通知をご確認ください。



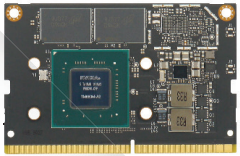
Jetson Xavier™ NX 16GB



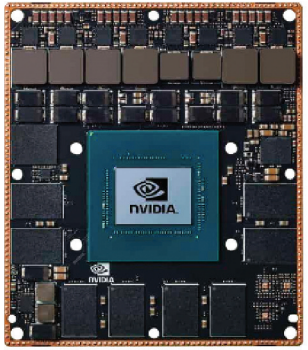
Jetson Xavier™ NX



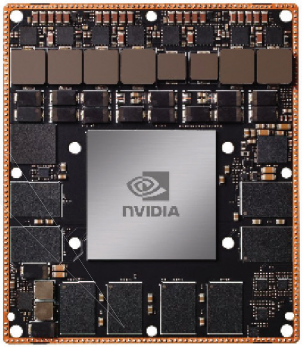
Jetson™ TX2 NX



Jetson™ Nano



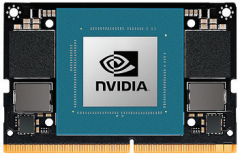
Jetson AGX Xavier™



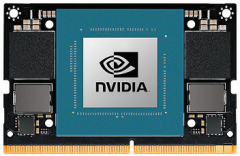
Jetson AGX Xavier™ Industrial

Jetson Orin™ NX 16GB

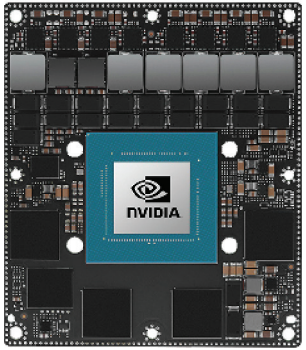
Jetson Orin™ NX 8GB



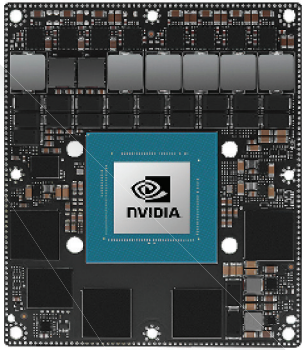
Jetson Orin™ Nano 4GB



Jetson Orin™ Nano 8GB



Jetson AGX Orin™ 32GB/64GB



Jetson AGX Orin™ Industrial

JETSON ORIN COMPARISON CHART

	Orin Nano 4GB	Orin Nano 8GB	Orin NX 8GB	Orin NX 16GB	AGX Orin 32GB	AGX Orin 64GB	AGX Orin Industrial
AI Performance	20 TOPS	40 TOPS	70 TOPS	100 TOPS	200 TOPS	275 TOPS	248 TOPS
GPU	512-core NVIDIA Ampere w/ 16 Tensor Cores	1024-core NVIDIA Ampere w/ 32 Tensor Cores			1792-core NVIDIA Ampere w/ 56 Tensor Cores	2048-core NVIDIA Ampere w/ 64 Tensor Cores	
CPU	6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU	6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU		8-Core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit CPU	8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU	12-core Arm® Cortex® A78AE v8.2 64-bit CPU	
Memory	4GB 64-bit LPDDR5	8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s	8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s	16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s	32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s	64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s	64GB 256-bit LPDDR5 (+ECC) 204.8 GB/s
Storage	Supports External NVMe				64GB eMMC 5.1		
Power	5W - 10W	7W - 15W	10W / 15W / 20W	10W / 15W / 25W	15W - 40W	15W - 60W	15W - 75W
PCIe	1 x4 + 3 x1 PCIe Gen3		3 x1 + 1 x4 PCIe Gen4		Up to 2 x8, 1 x4, 2 x1 (PCIe Gen4, Root Port & Endpoint)		
CSI Camera	Up to 4 cameras (8 via virtual channels)				Up to 6 cameras (16 via virtual channels)		
DL Accelerator	---		1x NVDLA v2.0	2x NVDLA v2.0			
Vision Accelerator	---		1x PVA v2.0				
Networking	1x GbE	1x GbE	1x GbE		1x GbE | 2x 10GbE		
Mechanical	69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector				100 mm x 87 mm, 699-pin Molex Mirror Mezz Connector		

実証済みのエッジ AI パフォーマンス

MLPerf® Inference ベンチマークによるテスト

MLPerf® Inference は、実世界の推論タスクにおける機械学習モデルのパフォーマンスを計測するために、MLCommons®によって開発された標準ベンチマークです。このベンチマークは、システムがAIワークロードをどの程度のレイテンシやスループットで処理できるかを評価します。

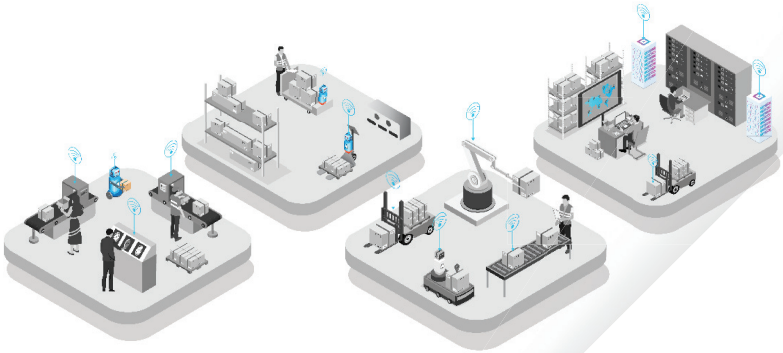
Connect Techの**Anvil Embedded System**は、NVIDIA Jetson AGX Orin™ 64GB SOMが組み込まれており、GPT-J 6Bモデルを使用してベンチマークを実施しました。 Single Stream Latency (ms) と Offline(Samples/s)の両カテゴリにおいて、卓越したパフォーマンスを発揮しました。

Connect TechのMLPerf®への参加は、エッジにおけるAIの進化に対する当社のたゆまぬ努力を示すものです。

詳細はこちら

Connect TechとNVIDIA ISAAC ROSによるリアルタイム・ロボティクス

Connect TechのEdge AIハードウェアとNVIDIA Isaac ROSによるロボット開発の迅速化。私たちは、エッジでのロボティクスを強化するために、ハードウェアにさまざまなパッケージを実装しています。例は以下のとおりです：



NVIDIA Isaac™ Manipulator

- Isaac™ ROS cuMotion
- Isaac™ ROS NvBlox (3D Scene Reconstruction)
- Isaac™ ROS DNN Stereo Depth Perception (ESS)
- Isaac™ ROS Pose Estimation

NVIDIA Isaac™ Perceptor

- Isaac™ ROS Visual SLAM
- Isaac™ ROS NvBlox (3D Scene Reconstruction)
- Isaac™ ROS DNN Stereo Depth Perception (ESS)
- Isaac™ ROS Depth Segmentation (Bi3D)

- Isaac™ ROS Map Localization with Occupancy Grid Localizer
- ROS2 Gen AI Node (NanoVLM)

Connect TechのハードウェアでNVIDIA Isaac ROSを活用し、AI、コンピュータービジョン、カスタマイズ可能なパイプラインを最適化して、効率的で合理的なロボット開発を実現します。

ROS Compatible

EMBEDDED SYSTEMS

Rudi-NX

Rudi-NXは、最先端の性能が求められるアプリケーション向けのエッジAIコンピューティングデバイスです。Rudi-NXはJetson Xavier NXを搭載しています。

- 極めて小さなフットプリント: 135mm x 50mm x 109mm
- I/O: 4x GMSL, USB 3.0, USB 2.0, CAN 2.0b, USB OTG, RS-485, I2C, GPIO, SPI, PWM
- 1x NVMe(PCIe x4, 2280), 1x SDカード
- 動作温度範囲: -20℃ ~ +80℃

ESG602

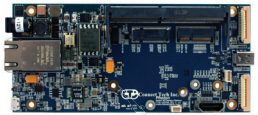
CARRIER BOARDS

Boson for FRAMOS

Boson for FRAMOSは、AIビジョンパワーハウスであり、非常に小さなフットプリント内に最大4台のFRAMOS社 MIPIカメラを統合します。

- Jetson Xavier NX/TX2 NX/Nanoに対応
- 4x 2-lane または 3x 4-lane MIPI FRAMOSセンサモジュールを統合可能
- 2x GbE および 2x USB
- 1x NVMe, microSDカード
- WiFi/Bluetooth拡張オプション
- 入力電源: +9V ~ +36V

NGX007

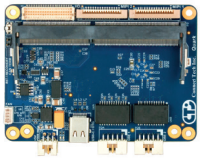


Photon AI Camera Platform

Photon AI Camera Platformは、スマートカメラアプリケーションに最適なJetson AIカメラプラットフォームです。

- Jetson Xavier NX/TX2 NX/Nanoに対応
- PoE PD対応(NGX002), 別入力またはイーサネット経由で給電
- 1x GbE, 1x NVMe(M.2 M-Key), 1x microSD, 4x GPIO, I2C, USB OTG, USB Console UART
- DCバレル電源入力も利用可能

NGX002/NGX003



Quark

Quarkは、手頃な価格で超小型の機能豊富なキャリアです。Jetson SODIMMモジュールとほぼ同サイズで、ビジョンアプリケーション、推論、無人ペイロードに最適です。

- Jetson Xavier NX/TX2 NX/Nanoに対応
- 小さなフットプリント: 82.6mm x 58.8mm
- 2x 2-lane MIPI CSI-2, 1x USB 3.1, 2x GbE, 1x USB OTG
- 1x SDカードスロット, 3x 3.3V UART, 2x I2C, 1x CAN 2.0b, 1x SPI

NGX004

Name	Hadron Carrier	Quark Carrier	Photon Carrier	Boson Carrier for FRAMOS
Part Number	NGX012	NGX004	NGX002/NGX003	NGX007
Dimensions	82.6mm x 58.8mm (3.25" x 2.31")	82.6mm x 58.8mm (3.25" x 2.31")	145mm x 64.5mm (5.7" x 2.53")	90mm x 75mm (3.54" x 2.95")
Ethernet	1x 1000BASE-T Ports • 1x GBE from Jetson GBE Port	2x 1000BASE-T Ports • 1x GBE from Jetson GBE Port • 1x GBE from PCIe x1 i210 PHY	1x 1000BASE-T Uplink • PoE IEEE 802.3af-2003 (15.4W) PD • PoE+ IEEE 802.3at-2009 (25.5W) PD	2x 1000BASE-T Ethernet Ports • 1 Port sourced directly from NX • 1 Port sourced from i210
USB + OTG	2x USB 3.1 1x USB 2.0 (OTG)	1x USB 3.1	1x USB 3.1, 1x USB 2.0 OTG 1x USB FTDI UART	1x USB 3.0 Gen 2 w/ OTG capability (Type C) 1x USB 2.0 (Type A)
MIPI Cameras	1x 4-lane MIPI CSI-2 22-pin FPC Connector	2x 2-lane MIPI CSI-2	2x 2-lane MIPI CSI-2	Up to: • 4x 2-lane MIPI FRAMOS Sensor Modules, or • 3x 4-lane FRAMOS Sensor Modules
Misc Interfaces	1x 3.3VTTL UART, 2x RS-232 Serial Ports, 4x PWM capable GPIO 1x 3.3V I2C, 1x 3.3V SPI	3x UARTs, 8x GPIO, 2x I2C 3.3V, 1x CAN 2.0b, 1x SPI	1x I2C, 4x GPIO, 1x Power Output	3x 3.3V TTL UARTs (1x CONSOLE), 8 GPIOs 3.3V TTL (2x PWM Capable), 2x I2C 3.3V, 1x CAN 2.0b, 2x SPI, 2x 3.3V, 2x 5V, 8x GND
Storage	1x 2242/2230 NVMe (M-Key)	1x Micro SD Card Slot	1x SD Card Slot 1x NVMe 2280 (M.2 M-KEY)	1x M.2 M-Key (2280) NVMe PCIe x4 1x Micro SD Card
Display Output	None (Headless Operation only)	None (Headless Operation only)	1x HDMI 2.0	
Wireless Expansion	1x 2230 E-Key Expansion for WiFi/Bluetooth	N/A	1x 2230 E-Key Expansion for WiFi/Bluetooth 1x 2230 B-Key Expansion for LTE/GNSS	1x 2230 E-Key Expansion for WiFi/Bluetooth 1x PCIe x1 + USB 2.0
Power Input	+9V to +60V DC	+5V DC Input (Positive Locking MiniTek Connector)	1x 2mm DC Barrel Jack +12V DC +/- 5%	+9V to +36V Input Voltage Range Auto-ON operation by default
Operating Temperature	-25°C to +85°C (-13°F to +185°F)	-25°C to +85°C (-13°F to +185°F)	-25°C to +85°C (-13°F to +185°F)	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)
Weight	49g (1.73oz)	33g (1.16oz)	76g (2.68oz)	80g (2.82oz)

Hadron、Photon、BosonはJetson Orin™ NX、Xavier™ NX、TX2™ NX、Orin™ Nano、Nano™に対応しています。
QuarkはJetson Nano™, TX2™ NX, Xavier™ NX SoMとのみ互換性があり、一部I/Oへの対応はモジュールによって異なります。

THERMAL SOLUTIONS

ACTIVE HEAT SINKS

Jetson Orin NX/Nano
XHG325

Jetson Xavier NX & Nano
XHG312, XHG314, XHG309

Jetson TX2-NX
XHG318

PASSIVE HEAT SINKS

Jetson Orin NX/Nano
XHG324

Jetson Xavier NX & Nano
XHG311, XHG308

Jetson TX2 NX - XHG317

THERMAL PLATES

Jetson Orin NX/Nano
XHG323

Jetson Xavier NX & Nano
XHG313, XHG310

Jetson TX2 NX - XHG316

Jetsonアクセサリー：

Connect Techでは、さまざまな拡張オプションとアクセサリを提供します。

提供しているアクセサリーは以下のとおり：
ケーブル, 電源アダプタ, カメラアダプタ, カメラ拡張ボード, エンクロージャ, 熱対策製品など

ACCESSORIES

Active Heat Sink

Active Heatsinkは、優れた冷却効果を発揮するファンを内蔵しており、NVIDIA Jetson モジュールの最適なパフォーマンスと寿命を保証します。

- NVIDIA AGX Orinに最適となるように設計されています。Jetson AGX Xavier モジュールとも互換性があります。
- ファンによってモジュールから発生する熱を放散します。
- サイズ: 100mm x 87mm x 54.5mm

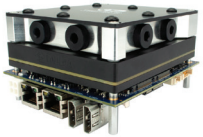
XHG319

Passive Heat Sink

NVIDIA Jetson AGX OrinおよびAGX Xavier モジュールの熱を効率的に放散し、最適なパフォーマンスと寿命を保証します。

- Jetson AGX Orinに最適となるように設計されています。Jetson AGX Xavier モジュールとも互換性があります。
- 対流によってモジュールから発生する熱を放散します。
- サイズ: 100mm x 87mm x 33.5mm

XHG320

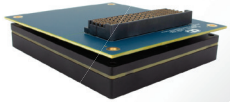


Liquid Cooling Block

優れた熱管理により、NVIDIA Jetson AGXモジュールを高負荷下でも冷却し、最高のパフォーマンスを発揮します。

- 産業グレードの液冷ソリューション
- 限られたスペース/エアフローのアプリケーションに最適
- カスタマイズ可能な8つのサイドポートにより、吸気口/排気口のフローを調整可能
- 静かで高性能な放熱ソリューション

XHG307

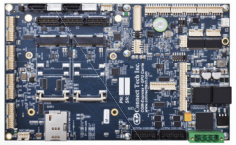


Connector Saver

NVIDIA Jetson AGX Xavier/AGX Orinのための Connector Saver は、AGX製品版モジュールに直接取り付けられ、コネクタの摩耗を防ぎます。

- 接点の損傷を最小化
- 嵌合および嵌合解除時の摩耗からコネクターを保護
- サイズ: 92mm x 105mm
- 互換性:
  NVIDIA Jetson AGX Xavier, AGX Orin; Connect Tech Forge, Rogue

ADG110



COM Express Type 6 + GPU Embedded System

COM Express Type 6 + GPU Embedded Systemψ " Μ ϱ ϵ ρ Ж χ NVIDIA GPU ρ Ω ϋ Ω ¸ χ x86 Φ κ J A Ъ б ʼ ϱ › Ƨ δ た ò σ I Я ． и T ɜ ． Э T ↑ ρ Ḱ χ ʼ ϱ ₅ ϱ Є I Γ Э です ‘

- GPUψ ϋ θ Д ж I Φ й ϱ ϒ " Ρ θ ψCUDAÚÈ † б ϋ θ X A Ж й I GPU ϒ Є I Γ Э б Ḱ ． Э A E ρ β Ч ά ρ Y π Φ Ρ β ‘

- CPU: Intel Raptor Lake(ピ13ぴピ), Alder Lake(ピ12ぴピ), Tiger Lake(ピ11ぴピ) χ Þ Φ Є д ρ Y г

- GPU: NVIDIA RTX A4500, A2000, A1000, A500(Ampere), RTX 5000, RTX 3000, T1000(Turing) χ Þ Φ Є д ρ Y г

VXG SERIES

COM Express Type 7 + GPU Embedded System

COM Express Type 7 + GPU Embedded Systemψ " 2x 10 GbE ρ Intel XeonÚ D (サーバークラス) Φ κ J A Ъ " Μ ϱ ϵ ρ Ж NVIDIA GPUб ϒ ĭ T ɜ ． Э T ↑ ρ Ḱ χ ʼ ϱ ₅ ϱ Є I Γ Э τ ᴇ › ϋ Ρ β ‘

- GPUψ ϋ θ Д ж I Φ й ϱ ϒ Ρ θ ψ CUDAÚÈ † б ► ϋ θ X A Ж й I GPGPU ϒ Є I Γ Э б Ḱ ． Э A E ρ β Ч ά ρ Y π Φ Ρ β ‘

- CPU: Intel Ice Lake D, Broadwell D, Denverton Ъ ． H ． ρ ж I χ Þ Φ Є д ρ Y г

- GPU: NVIDIA RTX A4500, A2000, A1000, A500(Ampere), RTX 5000, RTX 3000, T1000(Turing)のÞ Φ Є д ρが利用可能

V7G SERIES

V7G GPU System

V7G GPUシステムは、Intel Xeon D (サーバークラス)およびIntel Atom C3000 x86プロセッサーとハイエンドNVIDIA Quadro GPUをアルミニウムエンクロージャに搭載しています。ハーフラックレールマウントまたはスタンドアロンマウントブラケットが利用可能です。

- ハイエンドのビデオアプリケーションやGPGPU CUDA処理、ディープラーニング、AIアプリケーションに最適です。

- CPU: Intel Ice Lake D, Broadwell D, Denverton サーバークラスのオプションが利用可能

- GPU: NVIDIA RTX A4500, A2000, A1000, A500(Ampere), RTX 5000, RTX 3000, T1000(Turing) のオプションが利用可能

ESG7 SERIES

NVIDIA Elite Partner

Connect Techは、組み込み市場向けハイエンドコンピューティングプラットフォームのリーダーです。最新のNVIDIA GPUとXeon D(サーバークラス)およびIntel Atom C3000 x86プロセッサーを組み合わせた、携帯性に優れたコンパクトなシステムから選択できます。完全に密閉されたシステムと、お客様が設計した熱ソリューションのための非密閉システムがあります。

ESG701-01 - 2U Half-rack enclosure system

Product Features	NVIDIA® RTX A2000	NVIDIA® RTX A1000
GPU Architecture	NVIDIA® Ampere	
Peak FP32	9.3 TFLOPS	7.4 TFLOPS
CUDA Cores	2560	2048
RT Cores	20	16
Tensor Cores	80	64
GPU Memory	8GB | 4GB	4GB
Memory Type	GDDR6	
Memory Interface	128-Bit	
Memory Bandwith	192-Bit	
Maximum Power	60W / 35W	

AGX Orin

NEW!

Graphite VPX

Graphite VPX/AGX Orinは、NVIDIA Jetson AGX Orinを非常に堅牢な組み込みVPX市場にもたらします。3Uカードで、USB 3.2, DisplayPort, NVMeを搭載しています。

- 3U VPX SOSA † ж ϱ Ю p E
- NVIDIA Jetson AGX Orin Industrial
- PCIe x8 Gen4 (Endpoint or Host)
- 2x 10GBASE-KR ϱ ． Ъ K A E
- ą ȩ σ IPMIЂЪ ． E
- ■Ô NVMe 1TB/2TB

VPG004

GPU

COMING SOON

Graphite VPX/GPU

Graphite VPX/GPUは、NVIDIA RTX A2000およびRTX A1000 GPUを非常に堅牢な組み込みVPX市場にもたらします。VITA 65準拠の3Uカードで、最大4つのDisplayPort出力または2つのDVI出力を提供します。

- GPU Þ Φ Є д p :
  - NVIDIAÚ RTX A2000
  - NVIDIAÚ RTX A1000
- 3U VPX SOSA † ж ϱ Ю p E
- VITA 46/48/65 ϒ Ấ
- PCIe 3.0 (x8 / 2 ν χ x4) Д ． Ḱ Φ й ． p

10GbE

COMING SOON

Graphite VPX/10GBE

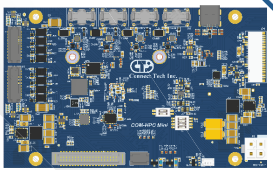
GraphiteVPX/10GbE マネージドイーサネットスイッチは、過酷な環境や極端な温度など、要求の厳しいアプリケーションに最適です。組み込みシステムの10GbE通信に高い信頼性を提供します。

- 3U VPX SOSA アライメント, 10G/2.5G/1G ϱ ． Ъ K A E I ϱ A Ў
- 12x 10G SERDESЪ ． E
- 10GBASE-KR/5GBASE-KR /2.5GBASE-KX/1000BASE-KX
- 24x 2.5G/1G þ A O ． Ъ ． E 2.5GBASE-T/1000BASE-T
- T и Ы K ． S Ж L2/L3 Ы и Ў й ϱ б ． I ϱ A Ў p Ɔ Ъ ． P I
- +85℃ ~ -40℃

COM Express Carrier Boards

COM-HPC MINI

NEW!



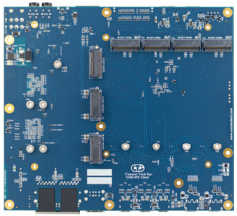
COM-HPC® Mini Carrier Board

最新のCOM-HPC® Miniのためのキャリアボードです。このキャリアボードは、幅広い接続性と、高速かつ堅牢なロック式コネクタを備えています。

- COM-HPC Mini 準拠
- 4x USB 3.2, 4x 2.5GbE
- 1x USB4/ディスプレイポート(Type-C)
- 1x M-Key 2280 (NVMe)
- 2x RS232, GPIO, I2C, CAN, SPI
- サイズ: 115mm x 70mm
- 温度範囲: -40°C ～ +85°C

HPC002

COM-HPC



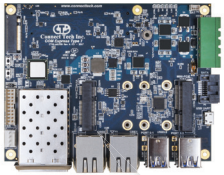
COM-HPC® Carrier Board

COM-HPC®プラットフォーム用キャリアです。このキャリアボードは、高速PCスタイルコネクタとロック式ピンヘッダーコネクタを備えています。

- COM-HPC クライアント用
- 2x 2.5GbE
- USB Type-C経由 USB4 x3
- 1x M.2 B-key, 1x M.2 E-key, x16-lane PCIe拡張
- サイズ: 160mm x 120mm
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

HPC001

TYPE 7



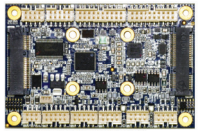
Type 7 Carrier Board

Type7 Carrier Boardは、ハイエンドのIntel® Xeon® Dクラス/Atom® C3000プロセッサへのアクセスを必要とするハイコンピューティング、エンタープライズレベルのアプリケーションに最適です。

- デュアル10GbE
- M.2 NVMe SSD対応
- 超小型フォームファクター: 125mmx95mm
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

CCG070

TYPE 10



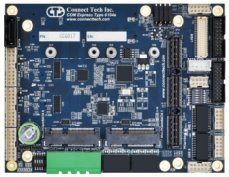
Type 10 Mini Carrier Board

Type10 Mini Carrier Board は、堅牢なロック式コネクタを特徴とし、究極の耐久性を提供する超小型キャリアボードです。

- 極めてコンパクトサイズ: 84mm x 55mm
- 2x mini PCIe, mSATA/SATA, 2x GbE, 6x USB, LVDS, DisplayPort/HDMI/DVI/VGA, HD Audio, 2x RS-232/422/485

CCG010/CCG020

TYPE 6

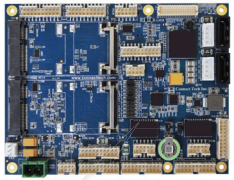


Type 6 104e

COM Express Basicモジュールに対応したコンパクトなキャリアボードです。堅牢なロック式ピンヘッダーコネクターにより究極の堅牢性を提供します。

- 4x USB 3.0, 2x GbE, LVDS(2x24), 2x RS-232/485, VGA
- PCIe/104 Type-1 (CCG018) またはPCIe/104 Type-22 (CCG017)
- オンボードDisplayPort/HDMI/DVI ディスプレイ切り替え
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

CCG017/CCG018

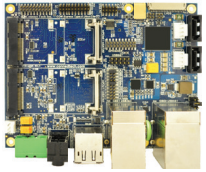


Type 6 Rugged Ultra Lite Carrier Board

Type6 Rugged Ultra Lite Carrier Boardは極めてコンパクトです。ロック式の堅牢なピンヘッダで究極の堅牢性を提供します。CCG011はUSB 2.0のみ、CCG012はUSB 3.0をサポートしています。

- Mini-PCIe拡張, USB 2.0, DisplayPort++対応
- コンパクトなサイズ: 95mm x 125mm
- 最新のIntel®プロセッサーをサポート
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

CCG011/CCG012



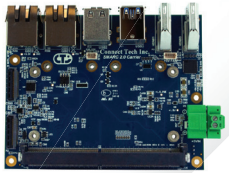
Type 6 Ultra Lite Carrier Board

Type6 Ultra Lite Carrier Boardは、標準的なPCタイプコネクタを搭載したコンパクトなキャリアボードで、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

- COM Express®Type6 互換性
- Mini-PCIe拡張
- 最新のIntel® プロセッサをサポート
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

CCG008

SMARC



SMARC 2.0 Carrier

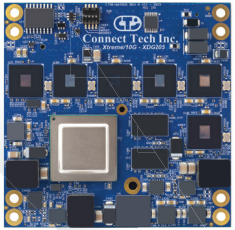
SMARC 2.0 Carrier は、低消費電力IoTアプリケーションに最適な超小型SMARCキャリアボードです。ユーザーは、統合されたオンボードワイヤレス機能を利用できます。

- 豊富な機能: HDMI, SATA, 2x MIPI CSI-2 カメラインターフェース
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x USB 2.0 to miniPCIe
- 入力電源: +5V DCのみ
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

SRG004

Embedded Ethernet Devices

10GbE



Xtreme/10G Managed Ethernet Switch /Router

Xtreme/10G Managed Ethernet Switch/Routerは高密度/多ポートで、L2スイッチングと10Gアップリンク付きL3ルーティングを提供します。85mm×85mmの超小型フォームファクタに、12x 10G/5G/2.5Gおよび24x 2.5G/1GbEのカッパーポートを備えた合計36のスイッチング可能ポートを搭載します。

XDG205は1588 PTPをサポートします。

- 前世代モジュール(XDG201/XDG202)と置き換え可能
- スイッチング可能な36ポート: 12x 10G/5G/2.5G, 24x 2.5G/1GbE
- 高密度 Board to Board コネクタ
- 入力電源: +4V ~ +14V
- サイズ: 85mm x 85mm
- 温度範囲: -40℃ ~ +85℃

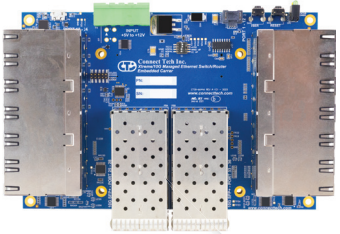
Managed Ethernet Switch用ソフトウェアパッケージ

Connect Techのソフトウェア設計チームは、業界をリードするファームウェアを使用して、当社のマネージドイーサネットスイッチ製品ラインのサポートを構築しています。

IStaX

XDG205

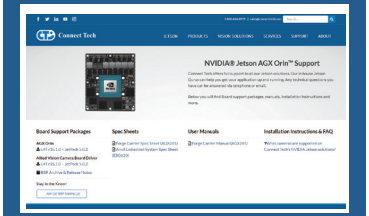
Breakout Board



Xtreme/10G Managed Ethernet Switch /Router Embedded Carrier

- PPS_IN/PPS_OUT IOサポート
- 改良されたRJ-45: 24x 2.5G/1G カッパーポート
- 8x 10G SFP+ポート
- XDG201のレガシーサポート
- USBおよびシリアルコネクタ
- 3.3V電源入力

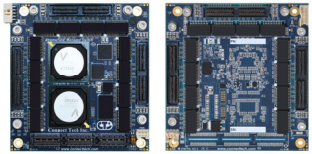
XBG305



CONNECTTECH.COM/SUPPORT

最新のBSPソフトウェア・アップデートをご利用いただくための情報を提供しています。当社のウェブページでは、購入したハードウェアのアップデートを購読することができ、最新の機能やアップデートを確実に利用することができます。

1GbE



Xtreme/GbE 24-Port Managed Carrier Ethernet Switch

Xtreme/GbE 24-Port Managed Carrier Ethernet Switch は、高密度/多ポートのキャリアグレード・イーサネットスイッチング機能を、非常に小さな組み込み型フォームファクタで提供します。組み込み型の高密度/多ポートのマネージドイーサネットスイッチを必要とする、スペースに制約のあるミッションクリティカルなアプリケーションに最適です。

XDG025は、スタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、すべての熱対策が一方のレイヤーに、コネクター/ケーブルは全てもう一方のレイヤーに配置されています。
XDG024はPCIe/104スタックに直接スタックすることを想定しています。

- 24x GbE(10/100/1000 Mbps)スイッチ
- 24ポート全てのオンボード統合
- Board to Board/Board to Cable 高密度なポートブレイクアウト
- 超小型サイズ: 90 x 96 mm
- 伝導冷却ヒートプレート または空冷ヒートシンクオプション
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

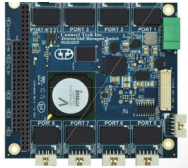
XDG024/XDG025

LINQ/GbE

LINQ/GbEは堅牢なマネージドイーサネットスイッチボックスです。LINQ/GbEシリーズは10/100/1000Mbpsのイーサネットポートを12または24ポート提供します。

- 12および24ポート10/100/1000 Mbps マネージドスイッチボックス
- 堅牢な密閉型RJ-45 Acclimateコネクタシリーズ
- IP68アルミニウムエンクロージャ
- L2+キャリアイーサネット管理
- 低消費電力, パッシブ冷却構造

ESG301/ESG302

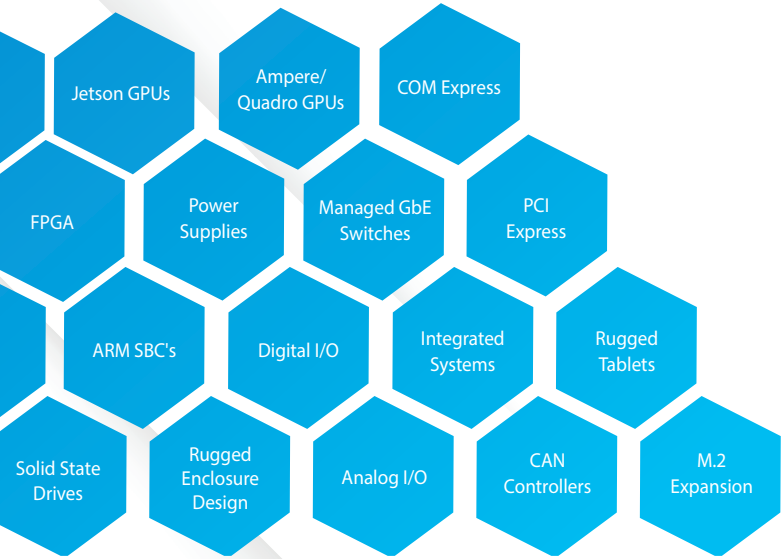


Xtreme/GbE Managed Carrier Ethernet Switchs

このイーサネットスイッチは、8ポートまたは16ポートの標準RJ45/堅牢なラッチングコネクタ、熱伝導プレート、PC/104、PCIe/104またはスタンドアローンオプションが利用可能です。

- 熱伝導プレートまたは空冷
- 8/12ポート 10/100/1000 Mbpsスイッチ
- キャリアグレードのイーサネットスイッチ
- RJ-45または 堅牢なロッキングコネクタを使用可能
- PC/104準拠: 115.57mm x 111.58mm
- 温度範囲: -40°C ~ +85°C

エンジニアリングサービス
-カスタム製品開発



標準製品の変更

カスタム設計

Connect Techのエンジニアリングサービス が選ばれる理由

- Connect Techの50%のビジネスはカスタム設計
- 明確で洗練されたカスタム設計プロセス
- 幅広いハードウェアソリューション を開発する 36 年以上の知見
- 前例のない Revision-A 成功率

Connect Tech

NVIDIA Elite Partner

Connect Tech Inc.は、NVIDIA® Jetson™のほか、COM Express、SMARCなどさまざまな業界標準の組み込み製品を幅広く提供する、NVIDIA最大のグローバルハードウェアパートナーです。社内設計および製造サービスにより、Connect Techはカスタム設計サービスの迅速な対応を提供し、開発から展開までを記録的な速さで実現します。

Connect Tech
A HEICO COMPANY

2020年8月、Connect Techは米国を拠点とするHEICO Corporationに買収されました。
HEICOは、航空宇宙、産業、防衛、エレクトロニクスの各市場で確固たる地位を築き、成功を収めている技術主導型の成長企業です。

Connect Tech Inc. - ISO 9001:2015 Certified
489 Clair Road West, Guelph, ON, Canada, N1L 0H7

[お問い合わせ]

KBK 極東貿易株式会社

産業インフラソリューションG
第三ユニット　後藤
Mail: yuta.goto@kbk.co.jp HP:
https://www.kbk.co.jp/ja

Connect Tech

www.connecttech.com

489 Clair Rd. W., Guelph, ON, Canada, N1L 0H7

CTIX-00026 Rev. 0.18

© Connect Tech Inc. 2024

[お問い合わせ]

極東貿易株式会社

産業インフラソリューションG
第三ユニット　後藤
Mail: yuta.goto@kbk.co.jp HP:
https://www.kbk.co.jp/ja